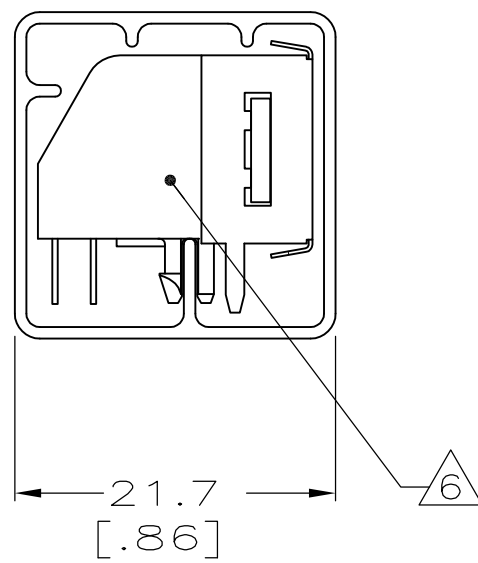
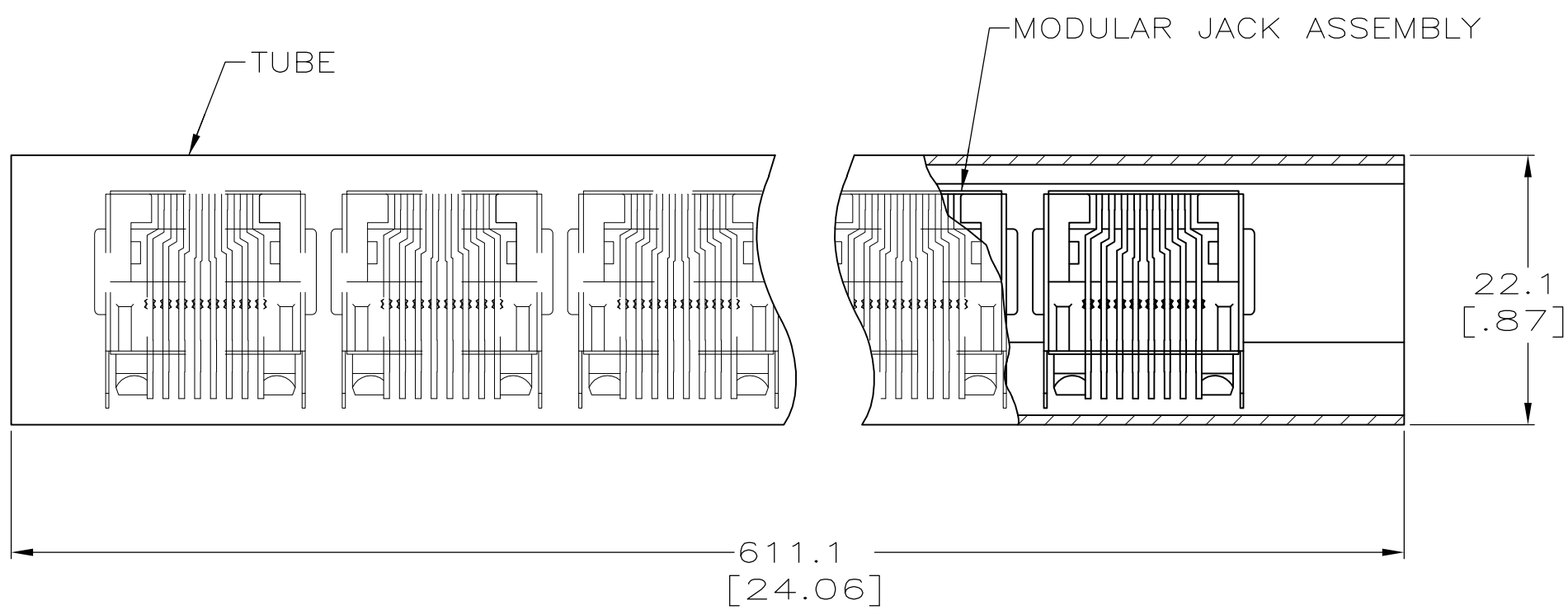
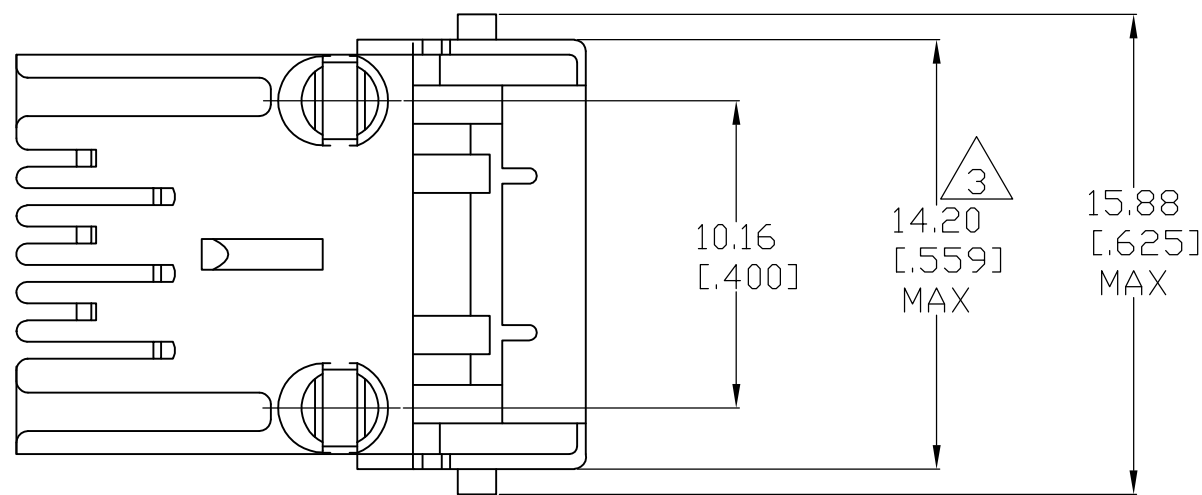
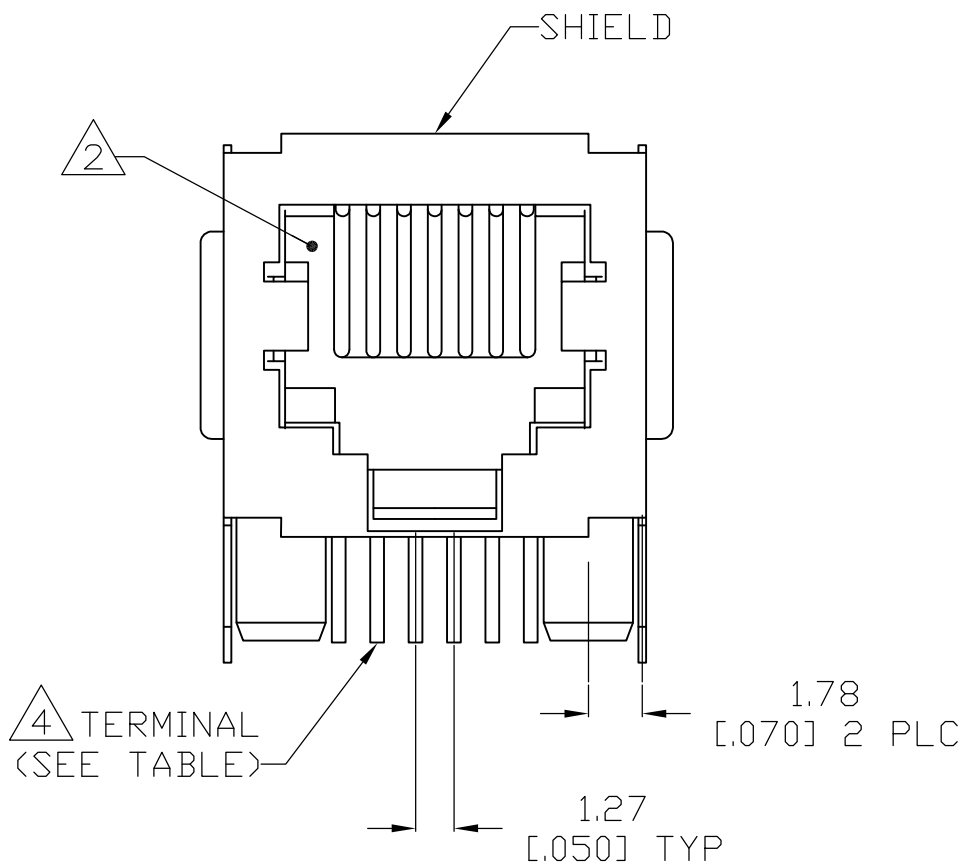
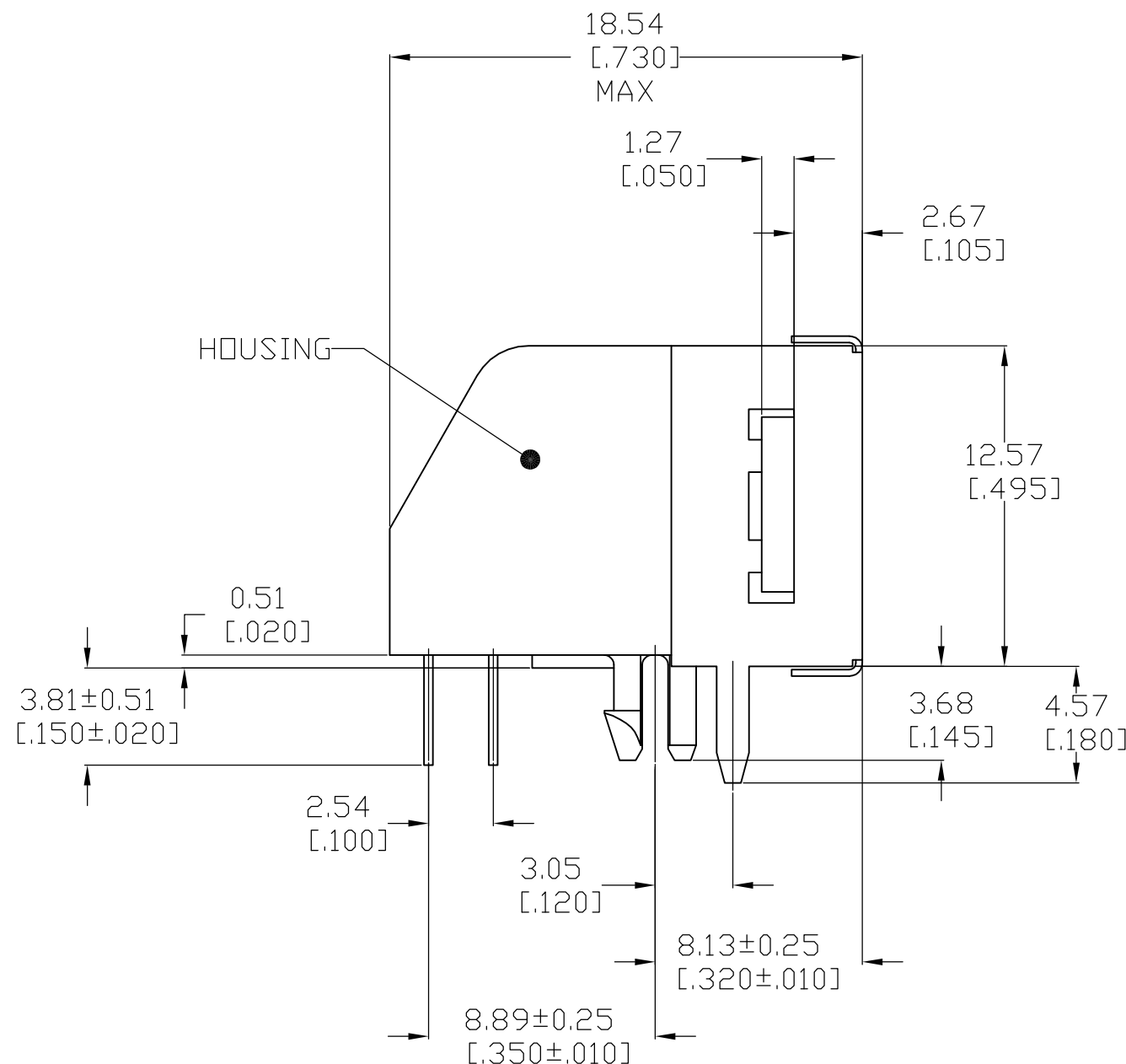


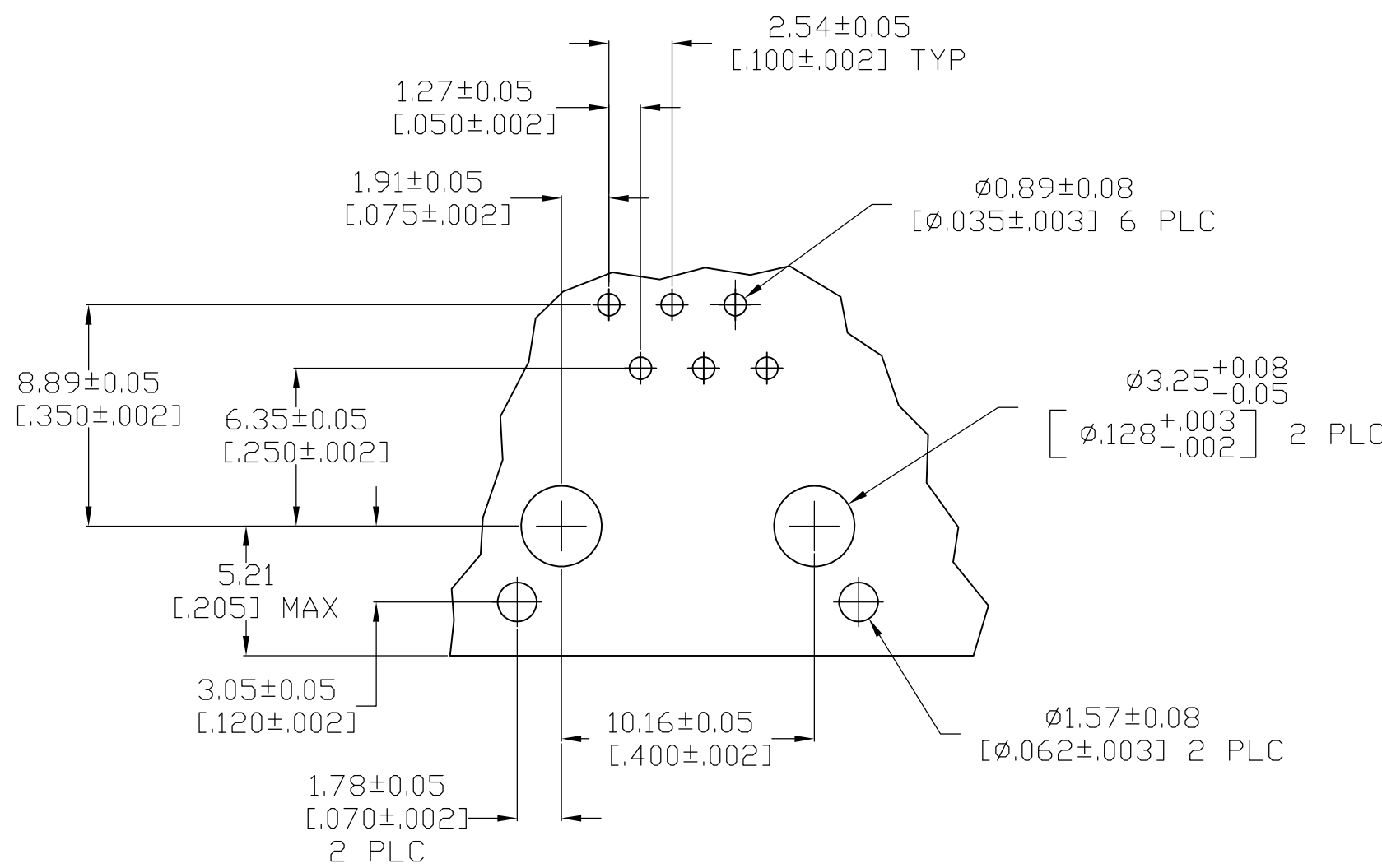
LOC		DIST		REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD	
		B1	REVISED	PER ECO-11-005033				

1. MATERIAL: HOUSING--PBT POLYESTER, COLOR: BLACK
TERMINAL- 0.36[.014] THICK PHOS-BRONZE PLATED WITH 1.27 μ m[.000050] MINIMUM THICK HARD GOLD IN LOCALIZED GOLD PLATE AREA AND 3.81 μ m[.000150] MINIMUM THICK MATTE TIN IN SOLDER AREA OVER 1.27 μ m[.000050] MINIMUM THICK NICKEL UNDERPLATE
SHIELD--0.25[.010] THICK COPPER ALLOY PLATED WITH 3.0 μ m[.000120] MINIMUM REFLOWED TIN

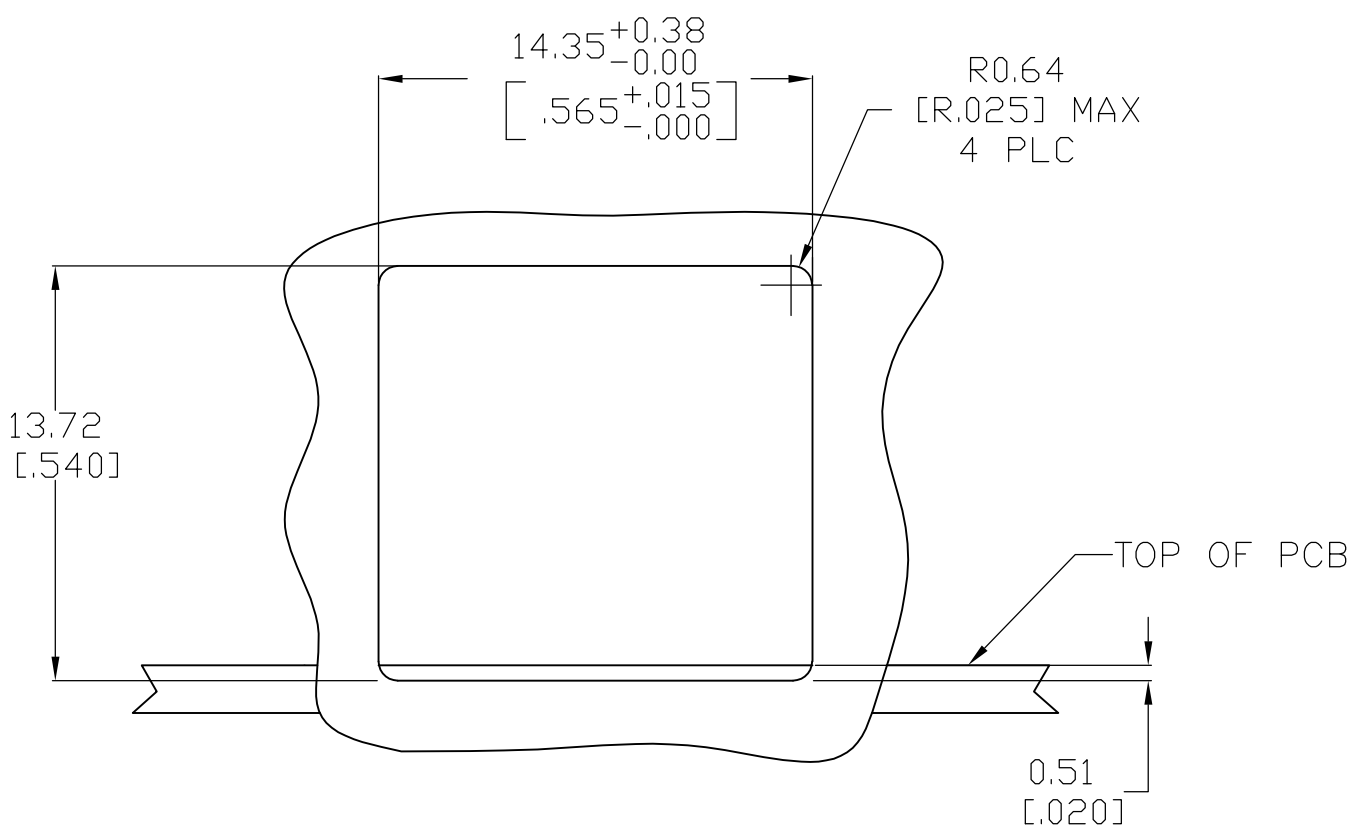
-  CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS PART 68, SUBPART F.
-  DIMENSION MEASURED ALONG FRONT EDGE OF MATING FACE
-  TERMINALS FOR 5555154-2 LOCATED IN CENTER POSITIONS.
-  BULK PACKAGED IN TRAYS.
-  PACKAGED 36 ASSEMBLIES PER TUBE. SEE DETAIL "A".



DETAIL A
SCALE 2:1

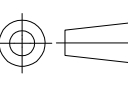


RECOMMENDED PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT
(COMPONENT SIDE)



RECOMMENDED PANEL CUTOUT

	6	5555154-4
	4 	5555154-2
	6	5555154-1
PACKAGE		PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN G. ATTADIA - 08/JUN/2005 CHK J. WESTMAN 08/JUN/2005	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	NAME	MODULAR JACK ASSEMBLY, SHIELDED, 6 POSITION, LOW PROFILE, RIGHT ANGLE, PRINTED CIRCUIT BOARD GROUND WITH PANEL STOPS
		1 PLC ± - 1 PCL ± - 2 PCL ± 0.15[.005] 4 PCL ± - ANGLES ± - FINISH	APVD S. FLICKINGER 08/JUN/2005	
MATERIAL SEE NOTE 1		PRODUCT SPEC 108-1163 APPLICATION SPEC 114-2048 WEIGHT -	SIZE A1	
SEE NOTE 1		CUSTOMER DRAWING	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=5555154
			RESTRICTED TO -	
			SCALE 4:1	SHEET 1 OF 1
			REV B	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9